



RE900-06

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para TSOP II 20, 24, 26, 28, 32 (1,27 mm)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la impresión de pasta de soldar
- Tamaño 26,50 x 30,94 mm

Módulo-No.	Typ	Pitch	Pin	Tamaño (mm)
RE900-06	TSOP II	1,270 mm	20, 24, 26, 28, 32	11,50 x 21,30